

PackageBond

基于引线框架的封装的粘结力改善

已验证的MSL-1 可靠性, 不发生分层

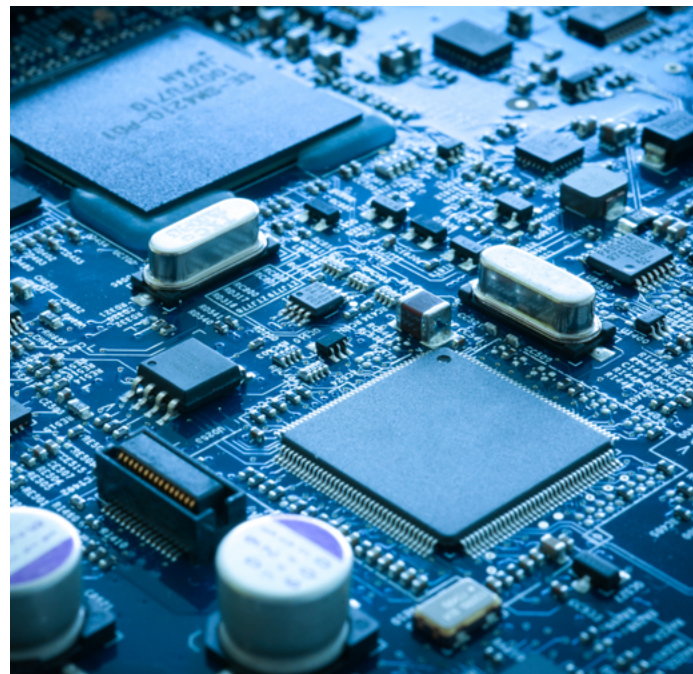
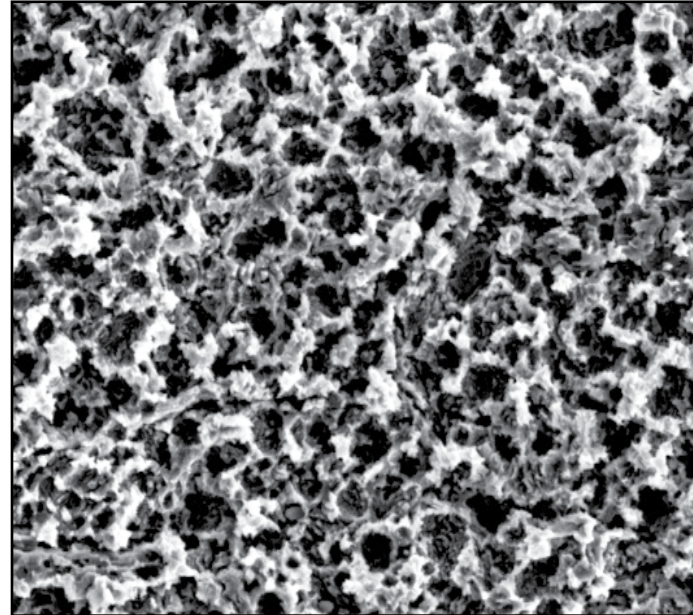
麦德美爱法的PackageBond是一种无风险的粘结力改善系统, 专门针对当今无铅电路装配温度下的可靠性而设计。在先进的半导体制造设施中经生产验证, 我们先进的实验室新技术可提供极高的耐热性。

PackageBond采用获得专利的化学成分, 可防止由于湿气/回流焊导致敏感的模塑封装产生分层失效。该工艺使铜合金引线框架变得粗糙, 从而最大限度地提高树脂和密封剂的附着力, 并加入薄的粘合增强剂, 以实现长期的分层保护。

PackageBond不会降低Ag或Ni / Pd / Au镀层引线框架的性能, 并且兼容引线键合、倒装芯片和铜芯片粘接技术。生产结果证实与上片粘合剂具有一致的相容性, 并且对树脂渗出没有不利影响。为了在所有湿度敏感度水平下具有出色的可靠性而不会发生分层和引线框架电镀破坏的风险, 请选择PackageBond。

主要特性优点

- 在MSL-1上证明可靠, 没有“爆米花”分层
- 显着提高现代芯片封装的粘结性能
- 形成干净的银表面以进行引线键合
- 可在传送带或批量模式下运行
- 可根据要求提供经批准的设备供应商
- 由麦德美爱法提供全面的客户和技术支持



PackageBond

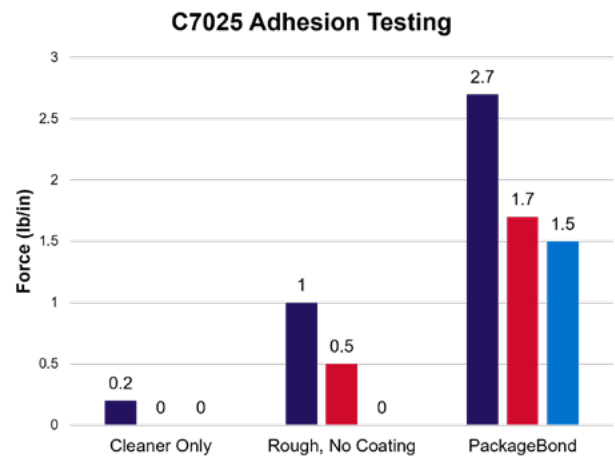
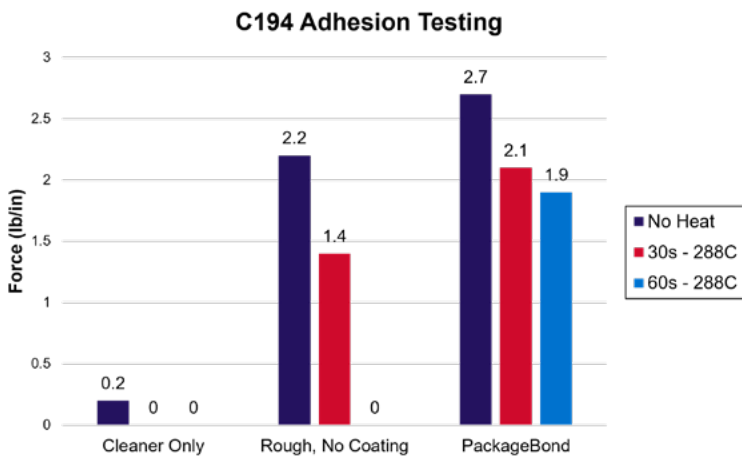
基于引线框架的封装的粘接力改善

精密粘接, 保证服务和支持

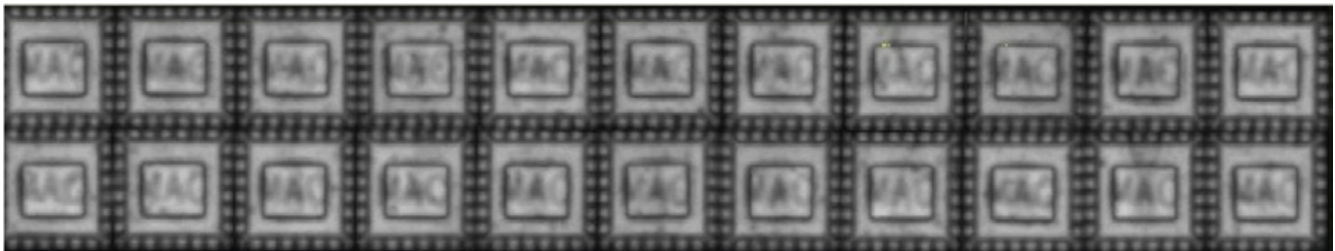
Package Bond是先进的引线框架粘合技术, 旨在克服分层问题, 实现MSL-1的可靠性。通过严格的测试和一致的市场内成功, PackageBond是高密度、复杂封装的最佳选择, 可在传送带或批量模式下运行。

麦德美爱法是先进表面处理的全球领导者, 致力于满足半导体行业不断变化的需求, 并继续提供基准客户和技术支持的传统。

EMC按钮剪切粘合力测试



符合MSL-1湿度敏感度标准



用C-SAM测量没有分层

